

メイショウ 商社機能の拡充に着手

受発注システム高度化を進める

SMT（表面実装）工程のトータルソリューションを展開する商社兼メーカーのメイショウは、2024年から商社機能の拡充に着手する構想を持つ。サプライチェーン（供給網）の改革を見据え、はんだ製品の受発注システムの高度化を段階的に進める。さらに装置の仲介には半導体後工程の設備を追加し、業域拡大を計画する。

同社は商社として棒 品の品質管理向上を促 品だ、はんだボール す仕組みづくりを段階 的に進めていく。川杉 製造現場は「製造現場 は経験を持つ人が減 少、不足している。お 客さまが簡単に業務を 行える仕組みを構築し たい」と語



川杉 社長

手間のか かる製品ご 社との識別 票貼付を出 荷の際に実 施。納入先 倉庫の整理 を促す。納 入先ごとに

製品・倉庫整理の仕組 みはあるが、構築する スキームは一步踏み込 み、製品の消費や発注 に関する情報管理に対 応する。川杉社長は 「当社が出荷を担うの で、製品の平均的な使 用期間は把握できる。 お客さまの納期に合わ せて、自動発注ではな く（注意喚起）のウォ ーニングが出せる」と

識別票貼付や倉庫管 理、受発注の高度化、 品質管理などはいずれ も煩雑さを伴う。個別 に分断された供給網を 改革することで、業界 のさらなる高度化を見 据える。川杉社長は 「煩わしいことを引き 受けるのが商社の役

割。『商社に何が求め られているか』へのア ンサーを提供したい」と 抱負を述べる。 後工程装置を仲介 一方、同社はSMT 工程のトータルソリュ ーションという形で商 社業務を展開してき

た。大型プロジェクト として、来年早々から 半導体後工程の装置の 仲介に着手する。川杉 社長は「7年ほど前か ら、業務の対象を半導 体の後工程に広げてい きたいと考えていた。 SMTのエンジニアリ ングサービスにも必ず

を開始する。BGAは、 製品の小型化に貢献す る半導体パッケージ。 相乗効果を狙

後工程の設備 知識を深める

1ストは消費期限情報 の管理を行う方針。ま た、はんだペーストで は使用開始後の管理も 検討する。これは現場 における、はんだペー ストの置き忘れ対策へ の配慮となる。 現段階では構想とし つつも、納入先の共同 発注によるコスト削減 を展望する。納入先は 競合関係にあり、共同 発注は進みにくいも の。同社が介入するこ とで、共同発注の進展 に期待を寄せる。

「発注」「見送り」な どを選択するだけ。は んだボールとはんだペ

「発注」

「見送り」

「発注」

「見送り」